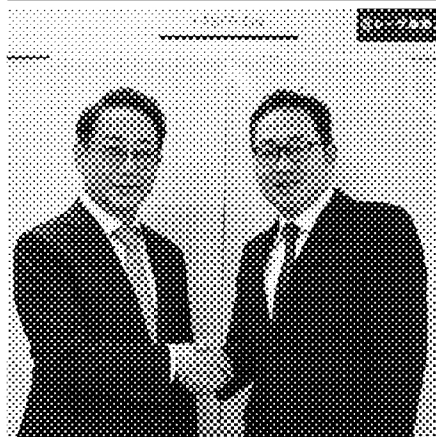


韓レーザー接合装置拡販

ナ・デックス 半導体基板反り低減

【名古屋】ナ・デックスは韓国のレーザーセル（京畿道東灘新都市）と国内販売代理店契約を結び、レーザーを利用して電子部品をプリント基板に接合するリフロー装置を投入する。レーザーセルの同装置に、自動車関連設備で培ったナ・デックスのシステムインテグレート（S-I）技術を組み合わせて供給。電気自動車（EV）用電池や次世代ディスプレイなどで増えている回路の高密度化、微細部品に適したリフロー技術として拡販する。

レーザーセルは基板の「ザ」エネルギーを均一に必要な部分だけに「レー」に分布させるレーザー



レーザーリフロー装置の国内販売代理店契約を結んだ進藤ナ・デックス社長（左）と安レーザーセル会長

照射技術をコアとする。照射領域は最大300ミリの角。

半導体チップの大型・薄型化や基板の面積積が進み、半導体パ

ッケージのリフロー工程では基板の反りの発生が課題となっていた。同装置は必要な部分だけに、均一な温度分布でレーザー照射することにより加熱のバ

ラつきを抑え、基板の反りを大幅に低減する。数秒以内という短時間でレーザーを照射し、従来のリフロー炉で5分程度かかる工程が2-3秒で完了する。レーザーを用いることで電気代が従来比10分の1に低減するほか、窒素ガスが不要になるなど脱炭素、環境負荷低減に貢献する。

ナ・デックスは溶接を中心とする接合機器の開発、製造で培ったS-I技術を生かし、同装置を核にした設備構築、保守に対応する。進藤大資社長は「自動車や半導体など幅広い領域で展開していく」と方針を示す。安建俊レーザーセル会長は「デバイス関連で、日本は大きな市場の一つ。ナ・デックスとともに成長したい」と期待を込める。